

半导体封装测试暨玻璃基板生态展

展后深度报告

未来半导体 | 2026年6月

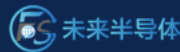


ITGV

2026

未来半导体生态大会

展会概览：基本信息



展会全称

半导体封装测试暨玻璃基板生态展

展览日期

2026年5月28日 — 5月29日
汇聚全球顶尖企业与专家资源

同期论坛

2026年5月27日 — 5月29日
沉浸式行业思想碰撞与交流



展览地点

无锡国际会议中心



主办单位

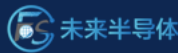
未来半导体



核心主题

链接芯生态 · 智创新机遇 · 玻动芯未来

战略定位：从技术展示到生态协同的跃迁



背景：产业发展的关键节点

随着AI算力需求爆发，行业竞争焦点已从单一芯片性能比拼，转向以先进封装技术和系统级集成方案为核心的创新突破，这是产业发展的关键分水岭。

定位：打造“产学研资”一体化生态平台

CSPT与ITGV的深度融合，构建覆盖半导体封装全产业链的高端生态，实现“论、展、谈、投”四位一体，链接技术、人才、资本与市场，赋能产业升级。



生态协同共生

打破上下游技术壁垒，促进材料、设备、设计与制造环节的全链条深度融合，构建互利共赢的产业创新共同体。



前沿技术聚焦

紧扣AI芯片驱动的技术浪潮，重点展示先进封装工艺与玻璃基板(ITGV)等关键技术，引领行业前沿探索方向。



行业风向引领

汇聚全球顶尖资源，成为行业发展趋势的重要发布窗口与资源密集度最高的年度盛会，为产业决策提供关键参考。

展会规模与核心板块



10,000

超大规模展览面积 (m²)

200+

海内外优质参展企业 (家)



先进封装技术展区

汇聚行业前沿成果，全景展示从芯片设计、微纳加工到系统集成的全流程先进封装技术解决方案。



玻璃基板生态展区

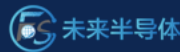
聚焦TGV（通孔玻璃）等关键材料，展示玻璃基板在高密度封装、光电集成领域的创新应用与生态构建。



工艺设备展示线

打造沉浸式实景产线，完整演绎先进封装量产全流程，为专业观众提供直观、深度的产线级观摩体验。

“双核生态” 成功落地，产业协同迈入新阶段



本次展会最大的亮点在于CSPT与iTGV的成功融合，标志着展会从单一的技术展览，正式升级为服务于全产业链生态协同的战略平台，为行业发展注入全新动力。



展会现场汇聚行业顶尖智慧，通过主题演讲与深度对话，促成了先进封装领域的技术交流与生态共识。



战略升级：构建全产业链全景图

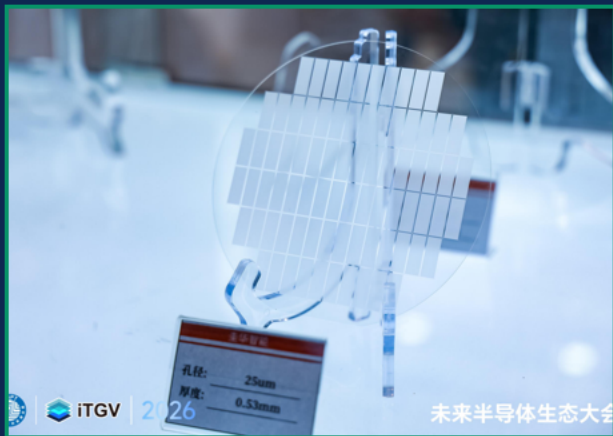
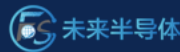
以“先进封装赋能AI算力”为核心，全景覆盖封测全产业链、玻璃基板/TGV、CPO光电融合、Chiplet异构集成及材料设备国产化等关键领域，确立行业发展新坐标。



生态链接：打通全流程协作闭环

有效链接上游材料设备、中游制造封测与下游终端应用，推动产业链深度对话，打破技术壁垒，加速前沿创新成果从实验室走向商业化落地。

全球首个玻璃基板AI芯片专业展，规模空前



展示了高精度、高纯度的先进封装玻璃基板实物，其优异的物理性能为下一代AI芯片的散热与封装提供了坚实的材料支撑。

作为全球范围内首场聚焦先进封装玻璃基板并面向下一代人工智能芯片的专业展会，本次活动汇聚了近200家海内外顶尖展商，打造了行业内规模空前的交流盛会。



行业聚焦：彰显中国实力

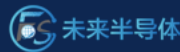
吸引全球行业目光，集中展示了中国在AI芯片先进封装领域的整体研发实力与最新技术进展，确立了在全球产业链中的重要话语权。



供需对接：赋能商业合作

搭建高效对接平台，连接AI芯片设计公司、终端厂商与封测、材料设备供应商，打通上下游链路，极大促进了技术转化与商业落地。

前沿技术高度聚焦，引领产业发展方向



展会通过“3大主论坛 + 10大专题论坛”的高密度议程，汇聚行业智慧，围绕半导体与集成电路领域最前沿的技术热点展开深入探讨与交流，为产业发展注入创新动力。



Chiplet与先进封装产业协同，全力保障前沿工艺落地。



技术风向标：锚定前沿赛道

多场论坛深度聚焦2.5D/3D IC集成、TGV、CoPoS、CPO光电融合、FOPLP等关键前沿技术，汇聚产学研力量，发布最新量产方案与清晰的技术演进路线图，为行业发展指引方向。



里程碑突破：硬核技术落地展示

现场重磅展示量产级TGV全流程AOI检测方案、TGV孔内金属化垂直互联玻璃基板等关键成果，实现从实验室技术向工业化应用的跨越，树立行业新标杆。

中国玻璃线路板产业联盟宣告成立



展会期间，由沃格光电等产业链领军企业共同发起的“中国玻璃线路板产业联盟”正式宣告成立，现场嘉宾共同见证了这一行业里程碑时刻。

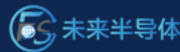
产业链整合：汇聚合力攻克瓶颈

联盟旨在深度整合产业链上下游优质资源，强化产学研用协同创新机制，集中力量突破关键材料与工艺技术瓶颈，推动玻璃线路板从实验室走向规模化、商业化应用，构建健康可持续的产业生态。

战略意义：提升产业全球话语权

联盟的成立标志着中国玻璃基板产业链协同发展迈入新阶段，将有力凝聚产业共识，提升我国在玻璃线路板领域的整体竞争力，增强在全球半导体显示产业链中的核心话语权。

CSPT Awards 2026颁奖盛典，树立行业标杆



展会同期举办了CSPT Awards 2026颁奖盛典，对过去一年在先进封装领域做出杰出技术突破与产业贡献的企业和个人进行了年度表彰，以权威评选致敬创新力量，凝聚行业发展共识。



表彰先进，致敬标杆

通过严苛的权威评选机制，表彰在技术创新、市场规模化应用及产业生态推动等维度表现卓越的标杆企业与领军个人，为行业发展树立价值典范。

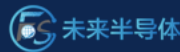


树立榜样，激励创新

盛典不仅是荣誉的见证，更向全行业传递创新精神与发展方向，激发企业加大研发投入、探索前沿技术的动力，持续推动先进封装产业的升级与变革。



前沿技术展示线开创行业先河



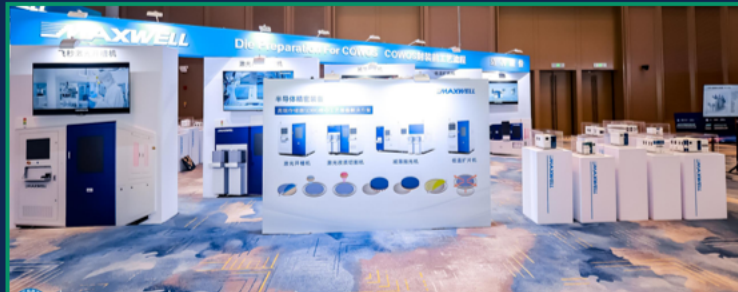
本届展会首次重磅落地了**TGV/CoWoS前沿技术展示线**，实景演绎了从键合、切割到电镀、光刻的先进封装量产全流程，将行业前沿的尖端制造工艺直观呈现，成为展会极具专业性与前瞻性的核心亮点。

产线级沉浸式观摩体验

为参会者提供了近距离观察先进封装量产全流程的珍贵机会，将抽象的技术原理转化为具象的工业实景，极大提升了展会的实操参考价值与专业深度。

加速前沿技术普及与推广

通过直观的实景展示降低了行业技术学习的门槛，让更多从业者理解并掌握先进封装工艺，有效推动了行业技术标准的统一，助力专业技术人才的培养与储备。



观众数据分析：总体规模与构成



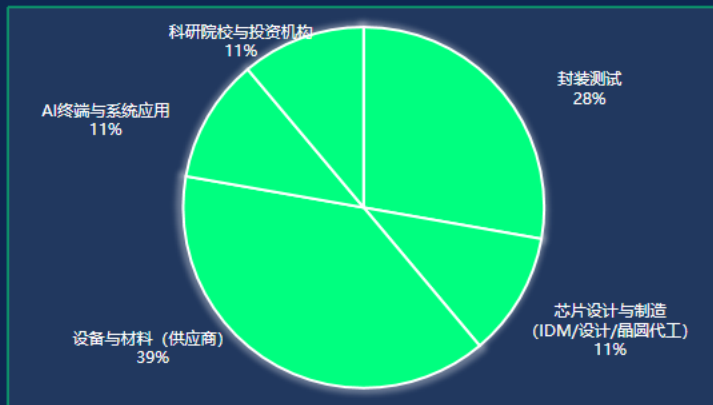
20,000+

展会总参观人次，覆盖行业核心受众群体，展现了极高的市场关注度。



6,000+

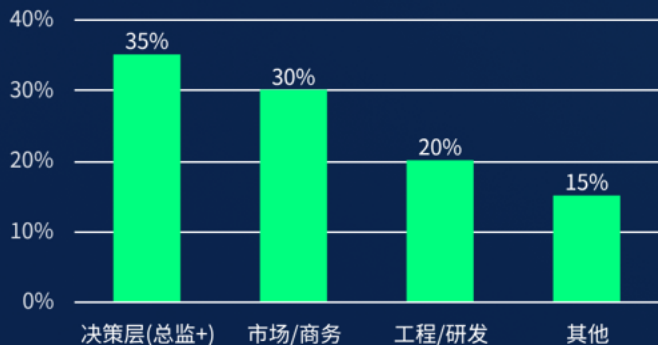
专业参会代表人数，汇聚产业链上下游决策层与技术骨干，交流价值显著。



分析显示，AI终端与系统、芯片设计与制造及封装测试企业合计占比达50%，展会成功覆盖了半导体产业链上游与中游的核心环节，形成了完整的产业生态闭环。

观众数据分析：职能与地域分布

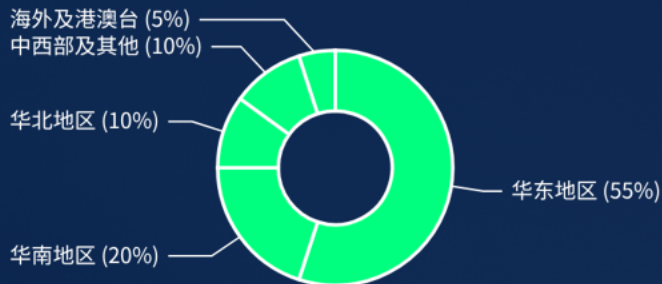
观众职能层级分布



决策层占比突出，商业价值显著

超三分之一观众为总监及以上级别，具备极强的采购与技术决策权，精准触达核心目标客户群体。

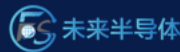
观众地域来源构成



华东为核心，辐射全国与海外

华东地区占比过半，是绝对核心市场；同时有效覆盖华南、华北及中西部，并吸引了国际观众参与，影响力持续扩大。

观众数据分析：核心企业云集



展会吸引了几乎囊括国内外半导体产业链的所有头部企业，从芯片设计、制造到封测的全产业链巨头齐聚一堂，构成了极具行业影响力的“多元立体观众团”，彰显了展会在半导体领域的核心号召力与商业价值。

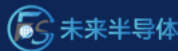
AI终端/系统应用层：

三星电子、SKC、华为、海思、字节跳动、中兴微电子、中兴通讯、燧原科技、壁仞、小米、oppo、未来印记、Qorvo、云天励飞、基本半导体、天数智芯、小米玄戒、飞存闪拓、安瞳半导体、国芯科技、威兆半导体、九州电器、浪潮电子、海思光电子、奕斯伟、光本位、莫仕通讯、瑞声科技、羲禾科技、灵睿智芯、飞腾、知存科技等

芯片制造/ID/封装测试层：

华虹、华润微电子、长鑫存储、长江存储、中芯国际、三星半导体、海力士、江波龙、增芯科技、晶合集成、新芯集成、长电科技、华天科技、日月光半导体、通富微电、华进半导体、华封集芯、三安集成、盛合晶微、盘古半导体、沛顿科技、德赛矽镨、越润集成、日月新、科阳半导体、锐杰微、京东方、南沙晶圆、歌尔微电子、物元半导体、睿芯峰、奕成科技、格芯集成、亿封智芯、中科芯、粤芯半导体、澄芯半导体、紫光集电、中科智芯、顾中科技、新核芯、云天半导体、中科四合、中微高科、中微腾芯、越摩先进、齐力半导体、天成先进、时代民芯、天芯互联、道铭微、矽迈微、芯德等

展商声音



RENA Technologies GmbH



The art of wet processing.

RENA Technologies GmbH以设备供应商身份参展CSPT & ITGV2026展会，依托大会专业展示平台，完整展出企业激光改性玻璃通孔（TGV）刻蚀工艺设备解决方案，并受邀在TGV专题技术论坛做专项技术分享。本届展会深耕细分产业链，上下游制造企业与采购商云集，供需对接精准高效，是设备厂商直面终端客户的优质商务合作载体；同期论坛紧扣TGV前沿工艺发展趋势，技术内容参考价值突出，有效提升了RENA在TGV专用设备赛道的品牌影响力与行业曝光度。

本次参展成效获得集团总部充分肯定，展会搜集的行业资讯，为RENA研判国内TGV市场需求、优化本土化战略布局、制定中长期发展规划提供关键数据支撑。我方高度认可未来半导体主办团队的办展专业度、行业影响力及市场调研数据的权威性。

衷心感谢未来半导体的邀约，助力RENA作为境外设备企业，在高规格、专业化行业平台中完成技术成果发布，并与业内同行深度交流TGV技术落地与行业市场研判。

SCHMID Group



参与ITGV 2026会议，我方深切感受到本次盛会超高的办会水准，这是一场兼具专业性、精准性与实效性的优质行业盛会。本次参会人员整体专业素养极高，汇集了全行业上下游资深技术专家、行业深耕者及各企业核心管理层，参会嘉宾行业经验丰富、认知前沿深刻。在交流研讨环节，各方分享的专业观点极具参考价值，为我方学习行业先进经验、拓宽行业视野提供了极大助力。

本次会议的客户精准对接服务让我方收获颇丰。主办方深度贴合行业发展与企业合作需求，严格筛选、精准匹配参会供需资源，有效打通了行业对接渠道、破除合作壁垒。通过本次会议，我方精准对接上优质的上下游合作资源，搭建了高效稳固的沟通桥梁，大幅提升了商务洽谈与深度合作的可能性，对接成果十分可观。

整场会议综合质量出众，整体流程规范严谨、议程规划科学细致。会议内容紧密贴合2026年行业全新发展趋势，干货充足、实用性与专业性兼备。同时现场组织有序、氛围浓厚，互动交流环节设计合理、体验极佳。本次参会让我方实现了高效学习、深度交流与资源整合，极大赋能了企业后续业务发展，我方对本次会议高度认可，会议圆满达成了行业交流与赋能的核心目标。

玻芯成 (重庆) 半导体科技有限公司



本次参与 ITGV 2026 会议，我们深切感受到大会专业、高效的办会水准。本次盛会汇聚了产业链上下游技术专家与企业高管，嘉宾视野前沿、经验丰富，分享的技术观点与行业洞察极具借鉴意义，帮助我们拓宽了行业视野，吸收了前沿技术经验。

会议精准的供需对接服务成效显著，主办方高效匹配上下游资源，助力我们对接了多家优质合作伙伴，搭建起良好的商务沟通渠道。

北京北方华创微电子装备有限公司



5月底，CSPT 半导体封装测试暨玻璃基板生态展在无锡顺利举办。北方华创积极参与本次行业盛会，安排专业销售团队驻展交流，同时公司领导受邀出席会议并发表专题报告。展会汇聚封装产业链众多企业，集中展示了先进封装、TGV 玻璃基板、Chiplet 等前沿技术与应用方案，行业热度十足。

驻展团队依托展位，与到访客户、同行深入洽谈，分享公司在封测配套设备领域的技术优势与解决方案，高效开展商务对接。领导的专题报告结合产业发展现状，解读技术迭代趋势与行业发展机遇，获得现场业内人士广泛认可。

本次展会组织规范、交流氛围浓厚，为产业链协同发展搭建了优质平台。通过参展参会，我们进一步加强了行业联动，拓宽了合作渠道，也更加明晰了产业发展方向。后续北方华创将持续深耕封测设备领域，以技术创新助力国内半导体产业高质量发展。

2027 未来半导体生态大会暨展览

“芯封玻引，智算无界——共创AI驱动的半导体融合生态”



举办日期

2027.05.12 — 05.14



举办地点

无锡国际会议中心



观众规模目标

突破**25,000**人次

展位火热预定中！ 诚邀全球合作伙伴共赴这场半导体行业的未来之约